

股票代码：300128

股票简称：锦富技术

苏州锦富技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

| | |
|-------------------|---|
| 投资者关系活动类别“选中项请打√” | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称（排名不分先后） | 申万菱信、华创证券、浙商证券、泉果基金、淡水泉基金、东吴证券、浦银基金、中银基金、银河基金、平安资产、和谐健康保险、西部证券 |
| 时间 | 2025年12月17日（星期三） |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：殷俊 投关总监：陈勇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司当前液冷业务的核心产品形态是什么？主要应用在哪些平台？ 锦富技术现阶段的液冷业务主要为控股子公司常熟明利嘉金属制品有限公司（以下简称“公司”）近年来主攻的（外接式）冷板式液冷模组核心部件制造业务，产品通过冷板内部流道与液体循环实现对GPU/CPU的直接散热，适配高功耗AI芯片的连续运行需求。从应用平台看，公司产品主要用于B系列芯片对应的HGX类服务器结构，在高算力密度、机柜级部署场景中已形成稳定出货。 |

2、在目前已经有规模出货的液冷相关项目中，公司承担的具体角色是什么？

公司目前定位为液冷模组核心部件的机加工与制造方，覆盖外接式冷板、导流结构及相关金属部件，后续还将延伸至液冷模组的设计制造。公司不参与软管、快接头等系统集成环节，而是聚焦高精度加工、焊接与一致性交付。在多个项目中，公司实现单一项目内多部件同时承接，提升单机价值量，也增强了在客户体系中的不可替代性。

3、公司目前订单情况如何？产能情况如何，是否有扩产计划？

目前公司产能已经全线排满，已经完成新一轮的扩产，预计春节前可以投产。目前已经实现冷板及配套品类千万级别规模出货，预计年底投产后订单量级会有提升。

4、公司当前冷板方案在技术路径上与其他方案相比，有哪些差异？

公司采用的是小型化、贴近GPU布局的外接式冷板方案，更适配主流HGX服务器结构。与面向GB类大型准系统的超大尺寸散热板相比，该方案在空间利用率、系统适配性及部署灵活性方面更具优势。在结构上，冷板由铜质上下板与鳍片通过高压焊接形成密闭流道，冷却介质直接与内部鳍片接触，提升换热效率，适合当前主流B系列芯片的功耗水平。

5、公司如何看待当下液冷渗透率提升的确定性？

随着AI服务器单机功耗持续提升，传统风冷方案已逐步接近物理极限，目前来看英伟达、超威、摩尔线程、壁仞等国内外主流AI芯片均采用液冷方案，液冷在高端AI服务器中的应用具备很强确定性。

6、公司在微通道液冷技术上的布局进展如何？

在现有冷板方案基础上，公司已推进微通道液冷技术的研发。相较传统冷板，微通道通过显著缩小内部流道尺寸，提升单位面积的换热效率，以应对下一代更高功耗芯片需求。目前该技术仍处于验证与送样阶段，尚未形成量产贡献，但公司已完成关键制程能力的内部验证，为后续平台导入做准备。

7、微通道技术与 Rubin Ultra 平台的关系如何？

Rubin Ultra 被市场普遍视为下一代高端AI平台，其散热方案预计将从模组级升级至封装级液冷。在该技术路径下，微通道冷板需嵌入封装体系，对加工精度、焊接可靠性及良率控制提出更高要求。公司已参与相关前期测试与送样工作，并获得小量订单用于客户的试产验证。该平台仍处于设计与验证阶段，量产节奏取决于上游平台推进情况。

8、公司最核心的竞争力体现在哪？

公司核心竞争力在于深度融入台湾高端半导体与服务器产业链。公司与台湾客户A保持长期合作关系，参与其高端AI服务器液冷散热项目；同时，台湾客户A与台积电在先进制程与先进封装领域高度协同，使公司能够较早参与新技术验证。这种产业链层面的绑定，使公司在新平台导入阶段具备先发优势。

9、回到公司整体业务结构，传统业务与其他创新业务如何定位？

除液冷业务外，公司仍保有一定规模的传统金属加工业务，为整体经营提供稳定基础。同时，公司也在推进若干材料与结构类创新业务，技术属性较强、验证周期较长，目前体量

| | |
|----------|---|
| | 尚小。 整体来看，传统业务提供稳定性，新业务提供弹性，而液冷业务是公司当前重点成长的方向。 |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2025 年 12 月 17 日 |